

2023年12月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年8月14日

上場会社名 ウィンテスト株式会社
コード番号 6721 URL <https://www.wintest.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 姜 輝
問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 樋口 真康
四半期報告書提出予定日 2023年8月14日
配当支払開始予定日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
TEL 045-317-7888

(百万円未満切捨て)

1. 2023年12月期第2四半期の連結業績(2023年1月1日~2023年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年12月期第2四半期	186	69.8	249		239		240	
2022年12月期第2四半期	109	37.8	349		323		325	

(注) 包括利益 2023年12月期第2四半期 207百万円 (%) 2022年12月期第2四半期 248百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年12月期第2四半期	6.29	
2022年12月期第2四半期	9.59	

(注) 2023年12月期第2四半期及び2022年12月期第2四半期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年12月期第2四半期	1,910		1,578		82.1	
2022年12月期	1,902		1,352		70.6	

(参考) 自己資本 2023年12月期第2四半期 1,568百万円 2022年12月期 1,343百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年12月期		0.00		0.00	0.00
2023年12月期		0.00			
2023年12月期(予想)				0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2023年12月期の連結業績予想(2023年1月1日~2023年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,300	518.1	50		50		50		1.30

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 有 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(注)詳細は、添付資料P12「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2023年12月期2Q	39,972,000 株	2022年12月期	36,072,000 株
期末自己株式数	2023年12月期2Q	株	2022年12月期	株
期中平均株式数(四半期累計)	2023年12月期2Q	38,223,691 株	2022年12月期2Q	33,908,368 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。また、上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(1) 経営成績に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	12
(会計方針の変更)	12
(セグメント情報等)	13
(重要な後発事象)	13
3. その他	14
継続企業の前提に関する重要事象等	14

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間（2023年1月1日～2023年6月30日）における世界半導体市場を、2023年4月時点での半導体世界売上高で分析すると、前月比で僅かながら0.3%増加し、これにより2か月連続で前月を上回る結果となりましたが、この成長は、特に中国市場の回復によるものでした。中国は金融の緩和を行っているものの、水面下ではゼロコロナ政策と同様の規制を続けており、2022年8月から2023年2月までの7か月間、半導体売上高が前月比で減少していました。しかし、中国の半導体売上高は、2023年3月にわずかながら増加し始め、4月には増加率が1.7ポイント上昇して、2.9%の成長を記録しました。中国の半導体売上高は、世界全体の売上高の約28.6%を占め、依然として世界最大の市場となっています。このように一部では回復の兆しはみられるものの、同市場における投資は限定的で、例えば、当第2四半期連結累計期間の前年同月比では、半導体世界売上高は21.6%減少しております。この前年比の減少は、2022年8月から続いており、当初は2023年上半年には在庫調整も一段落するものと予測されておりましたが、回復にはまだ時間がかかるとされています（WSTS及び日経誌データより）。半導体産業は、マクロ経済の低迷や景気の先行き不透明性、在宅需要のピークアウト、インフレーション、地政学的リスクなどの要因によって影響を受けており、2023年6月末時点においてもまだ、スマートフォンやPC、民生機器などの需要低迷が響き、同機器で使用される半導体を中心にだぶつき感が否めない状況が続いています。

ただし、自動車の電動化や再生エネルギー関連の用途においては、需要が引続き強く見込まれており、また、急速に需要が高まっている生成人工知能（AI）も一部のロジックICの需要を押し上げる要因となっています。

半導体産業の統計を提供するWSTSは、2023年通年の半導体世界市場を前年比で10.3%縮小すると予測しています。これによれば、2023年は2019年以来の4年ぶりの市場縮小となる見込みですが、2024年には、市場が回復し、前年比で11.8%の増加を記録するとの見通しも示しています。

日本市場においては、2023年は自動車用途などの半導体需要の下支えによって前年比1.9%成長すると予測され、市場規模は約6兆4,494億円に達するとされています。そして、2024年には成長が加速し、同市場は7.8%成長して約6兆9,537億円に達するとの予測があります。

このような環境下、2023年度における当社グループの主要事業である半導体検査装置事業分野では、EETIMESから引用すると、中国向けを含む市場規模として、前年比23%減の3兆201億円と予測されています。この予測は、半導体の需要低迷が長引いたことによる大幅な下方修正が背景にあります。しかし、2024年以降は、生成人工知能（AI）向けのデータセンターの拡大や電気自動車（EV）、仮想現実（VR）端末の普及により、需要回復が期待されています。世界的な景気の低迷により、半導体製造装置の世界売上高も2023年には前年比19%減の874億ドルになる見通しで、PCやスマホ向け半導体を製造する、韓国サムスン電子や米マイクロン・テクノロジーも大幅な生産調整による減産を行っており、特にメモリーやロジック分野の装置売上高は28%減、市場を引っ張ってきたNAND分野も51%減の見通しです。しかし、中国景気の回復などで民生品の需要が上向き、2024年には再び1,000億ドル台を回復すると見られています。当社としては、市場の上昇機運は未だ弱いものの、より高速高精度な半導体、特に高画素化が求められているLCDドライバーICに注力し、引続きお客様のニーズを取り込んだ、既存装置の改良、改善そして次世代デバイス向け検査装置の開発を継続することで、2023年下半年から2024年かけて回復が予想される当該市場に注力してまいります。

当第2四半期連結累計期間においては、上述のように、お客様工場の在庫のだぶつきから生産調整による受注の遅れがあったことから受注及び売上は低迷いたしました。営業面では販売店に集中させていた、販売方法を見直し当社の製造子会社の営業を含めた直接販売を拡大することとし、現地マーケットに集中した営業展開を2023年8月より本格化いたしました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の当社グループの売上高は186,416千円（前年同四半期比69.8%増）、営業損失249,453千円（前年同四半期は営業損失349,286千円）、経常損失239,355千円（前年同四半期は経常損失323,882千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失240,594千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失325,120千円）となりました。

なお、セグメント区分については、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、第1四半期連結会計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を株式会社データゲート（大阪府大阪市北区）に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったため、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ8,313千円増加し、1,885,614千円

（前連結会計年度末比0.4%増）となりました。この主な要因は、売掛金が66,462千円増加したものの、現金及び預金が45,991千円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度に比べ53千円減少し、24,889千円（前連結会計年度末比0.2%減）となりました。この主な要因は、投資その他の資産のその他が53千円減少したことによるものです。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度に比べ200,595千円減少し、173,139千円（前連結会計年度末比53.7%減）となりました。この主な要因は、短期借入金が157,030千円減少したこと、買掛金が14,249千円減少したこと及び未払金が20,217千円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度に比べ16,487千円減少し、159,304千円（前連結会計年度末比9.4%減）となりました。この主な要因は、長期借入金が16,449千円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度に比べ225,342千円増加し、1,578,060千円（前連結会計年度末比16.7%増）となりました。この主な要因は、資本金及び資本剰余金が各々が216,669千円増加し、利益剰余金が240,594千円減少したことによるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

まず、上記で述べたように2022年8月から顕在化していた民生向け半導体の在庫調整も2023年上半期中には一段落するものと予測されておりましたが、回復にはまだ時間がかかる状況であり、半導体チップ、特に民生機器の一部である、スマートフォンやPC、そしてIT情報端末機器などの半導体製品にだぶつき感が発生し、各半導体工場における在庫抑制を目的とした生産調整が発生しました。そのためスマートフォンやPC向けパネルそしてパネルを駆動するLCDドライバチップ等の在庫増が嫌気され、デザインハウス及び大手OSATを中心に工場の稼働率は回復の兆しはあるものの、現時点では7割から8割程度であり、市場は新規設備投資に慎重な姿勢を崩しておりません。しかし、2024年を含む中期的には、自動車の電動化、再生エネルギー関連及び5Gへの投資需要が強く見込まれており、また、急速に需要が高まっている生成人工知能（AI）も半導体チップの需要を押し上げる要因となっていることから、市場は力強く成長すると見られております（Electronic Engineering Timesより、以下「EETIMES」という。）。

また、近年の半導体の複雑化や集積度向上（例、線幅4nmから2nm）は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性も要求されるため、半導体検査市場は、装置能力の向上に加えて装置台数の増加が期待される方向と考えられております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、スマートフォンやPC等の情報端末の液晶パネルの駆動に使われる「ディスプレイドライバIC」の検査に使用されております。また、それら情報端末には、「CMOSイメージセンサーIC」、「ロジックIC」など多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。現状足元では、上記のように半導体市場の足踏み状態が続いておりますが、中長期的には需要も戻り、大きな伸びが期待される分野です。

上述のような理由から当第2四半期連結累計期間中では、受注は低迷致しましたが、当社の主力検査装置「WTS-577SR」につきましては、2021年から販売を開始し、当第2四半期連結累計期間において、進化する新デバイスに向けた装置の貸出しを伴うベンチマークを積極的に進め、お客様から量産ラインへの投入評価をいただくことができました。

2023年の半導体市場は、世界半導体市場統計（WSTS）や日本貿易振興機構（JETRO）等の予想では、民生向け半導体（スマートフォン、PC向け半導体等）を中心として、依然として生産調整が2023年後半まで続くとの見方があります。他方、半導体製造装置セクターにおいては、2023年前半は落ち込むが後半から2024年にかけて徐々に回復との予測もあり、当社においては、半導体検査装置の受注は2023年2月14日に公表している通期予想に組込んでおります。

新戦略として、2023年3月6日に開示いたしましたとおり、新たに日本における大手再生シリコンウエーハ製造会社である株式会社RSテクノロジー（東京都品川区、代表取締役 方 永義）を販売店に迎え、国内外の受注拡大を狙います。

また、当社の中国製造子会社「偉恩測試技術（武漢）有限公司」（以下、「ウインテスト武漢」という。）の営業体制の拡大強化を行い、特に中国、台湾においての直接受注を目指します。また、海外営業と海外アフターサポート体制の拡充を進め、営業活動の再構築を図ってまいります。

次に、ウインテスト武漢においては、顧客対応力の強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。

さらに中国市場攻略のスピードアップを進めるため、ウインテスト武漢において、大手優良デザインハウス教社に的を絞った戦略を取り、関連するOSATへの貸出を進め、営業・納入・サポートと一貫体制を敷き、顧客から

の信頼獲得を図ってまいります。

先端ロジックIC検査装置 (1024チャンネル、820Mbps) に関しては、第1四半期に前倒しで一部機能のリリースを行い、引続き次世代向け機能としてロジックパターンスピードが1,600Mbpsとなる高速リソースの開発を継続しており、当第4四半期中には開発を終了し、お客様への提供を開始する予定です。更に「WTS-9000S」次世代のフラッグシップ検査装置に先立ち「WTS-577SX」のリリースを同じく当第4四半期を目途に計画しております。「WTS-577SX」に関して、国内、台湾、中国顧客向けを想定した開発を継続しており、多くの部分を現在開発中の次世代LCDドライバー検査装置へ共用の上、使い勝手の向上に向けて新GUIを装備し、コスト削減と市場への早期リリースができるように計画しております。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用し、且つ当社、ウインテスト武漢の技術陣に加え、現地有力企業より営業方面・技術方面での協力体制を構築することで、2025年までに、今後市場拡大が見込まれるシステムオンチップ (SoC) 市場や汎用デジタル市場等の検査分野、そしてM&Aも計画し、日本市場においても注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、資本提携や協力体制を積極的に進め、新規市場参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を行い、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

検査装置向け工場FA化機器技術 (「自重補償機構技術」) については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については、既にお知らせのとおり手続きは終了しております。当該技術は当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター (以下「ポゴタワー」という。) の着脱 (約25kg~30kg) をオペレーター一人で簡単に安全に行うための補助アーム (以下「マニピュレータ」という。) で製品化を目指し、当面の目標として、その搬送可能重量を50kg前後で製品化を行います。現在は、製品の製造準備に取り掛かっており、先端ロボット等の開発製造をロボット等製造事業者様と協議を開始いたしました。また当該技術は、「半導体製造工場内FA化システム」、「物流搬送システム」並びに「介護等」への応用が可能と考えております。

奈良県立大学と進めております脈波 (BCG, ECG) を利用したヘルスケア管理システムは、同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを組み、製品化を行いました。2023年3月9日に開示しました「IoTセンサーを活用したセルフヘルスケア機器の販売開始決定及び価格に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、2023年4月1日より一部のお客様を中心に試験販売を開始いたしました。なお、当該製品の製造に関しましては当社大阪事業所で製造を行うように準備を進めており、2023年9月から順次市場投入を計画しております。また、製品の納品後もアップデートによる機能の追加、検査項目の拡充を積極的に進め、地域医療に貢献できるようにしてまいります。なお、機器の詳細につきましては、当社WEBページをご参照ください。

なお、2023年2月15日の「2022年12月期 決算短信」で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	278,480	232,488
売掛金	21,058	87,520
電子記録債権	21,670	—
商品及び製品	215,344	193,499
仕掛品	797,167	820,702
原材料及び貯蔵品	506,251	532,306
前渡金	8,677	836
未消費税等	13,270	4,029
その他	15,381	14,232
流動資産合計	1,877,301	1,885,614
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物(純額)	—	—
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	△8,885	△8,885
車両運搬具(純額)	—	—
工具、器具及び備品	181,952	181,952
減価償却累計額	△181,952	△181,952
工具、器具及び備品(純額)	—	—
有形固定資産合計	—	—
投資その他の資産		
その他	27,827	27,773
貸倒引当金	△2,884	△2,884
投資その他の資産合計	24,943	24,889
固定資産合計	24,943	24,889
資産合計	1,902,244	1,910,504

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	21,750	7,500
1年内返済予定の長期借入金	32,064	32,064
短期借入金	157,030	—
未払金	75,020	54,802
未払法人税等	10,689	9,483
契約負債	45,696	34,899
製品保証引当金	300	552
その他	31,183	33,835
流動負債合計	373,734	173,139
固定負債		
長期借入金	169,030	152,581
リース債務	343	257
資産除去債務	6,418	6,466
固定負債合計	175,791	159,304
負債合計	549,526	332,444
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,210,563	1,427,232
資本剰余金	1,497,050	1,713,719
利益剰余金	△1,468,555	△1,709,149
株主資本合計	1,239,059	1,431,802
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	104,158	137,023
その他の包括利益累計額合計	104,158	137,023
新株予約権	9,500	9,234
純資産合計	1,352,717	1,578,060
負債純資産合計	1,902,244	1,910,504

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
売上高	109,774	186,416
売上原価	79,883	91,015
売上総利益	29,890	95,401
販売費及び一般管理費	379,176	344,854
営業損失(△)	△349,286	△249,453
営業外収益		
受取利息	38	26
為替差益	26,737	14,605
その他	737	1,770
営業外収益合計	27,512	16,402
営業外費用		
支払利息	1,623	3,348
支払手数料	—	1,811
その他	484	1,145
営業外費用合計	2,108	6,305
経常損失(△)	△323,882	△239,355
税金等調整前四半期純損失(△)	△323,882	△239,355
法人税、住民税及び事業税	1,238	1,238
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	1,238	1,238
四半期純損失(△)	△325,120	△240,594
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△325,120	△240,594

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
四半期純損失(△)	△325,120	△240,594
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	76,749	32,864
その他の包括利益合計	76,749	32,864
四半期包括利益	△248,370	△207,729
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△248,370	△207,729
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失 (△)	△323,882	△239,355
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△1,607	252
受取利息及び受取配当金	△38	△26
支払利息	1,623	3,348
為替差損益 (△は益)	△15	0
売上債権の増減額 (△は増加)	22,343	△44,385
棚卸資産の増減額 (△は増加)	25,921	26,951
前渡金の増減額 (△は増加)	9,623	7,851
仕入債務の増減額 (△は減少)	△59,612	△23,357
未払又は未収消費税等の増減額	38,292	9,241
その他	32,553	△41,560
小計	△254,797	△301,041
利息及び配当金の受取額	38	26
利息の支払額	△1,623	△3,348
法人税等の支払額	△848	△2,477
法人税等の還付額	11,858	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△245,372	△306,840
投資活動によるキャッシュ・フロー		
敷金及び保証金の差入による支出	—	△300
投資活動によるキャッシュ・フロー	—	△300
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の返済による支出	—	△156,235
長期借入れによる収入	120,000	—
長期借入金の返済による支出	△13,275	△16,449
リース債務の返済による支出	△459	△85
新株予約権の発行による収入	3,625	4,914
新株予約権の行使による株式の発行による収入	213,376	428,424
その他	△1,556	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	321,711	260,568
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,593	580
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	87,932	△45,991
現金及び現金同等物の期首残高	219,109	278,480
現金及び現金同等物の四半期末残高	307,041	232,488

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

当社グループは、前連結会計年度において半導体需要のダブつきによる工場稼働率の調整の影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高210,315千円にとどまり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上いたしました。また、営業キャッシュ・フローは、613,481千円のマイナスとなりました。

当第2四半期連結累計期間においては、2022年8月から顕在化した民生向け半導体の在庫調整も2023年上半年には一段落するものと予測されておりましたが、在庫調整の回復にはまだ時間がかかる見込みです。そのため、2023年6月末時点において、スマートフォンやPCなどの需要低迷の影響から、主にそれら機器で使用される半導体を中心にだぶつき感が否めない状況が続いており、顧客の各工場が、生産調整に入っていることから当第2四半期連結累計期間中の受注は低調に推移しました。顧客の新規設備投資は当社第3四半期以降に開始される見込みです。

以上より、当第2四半期連結累計期間の売上高は186,416千円にとどまり、営業損失249,453千円、親会社株主に帰属する四半期純損失240,594千円を計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、306,840千円のマイナスとなりました。

上記のとおり、継続的な営業損失及び営業キャッシュフローのマイナスが発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

事業施策

1. 中国国内での受注販売活動の促進

まず、上記で述べたように2022年8月から顕在化していた民生向け半導体の在庫調整も2023年上半年中には一段落するものと予測されておりましたが、回復にはまだ時間がかかる状況であり、半導体チップ、特に民生機器の一部である、スマートフォンやPC、そしてIT情報端末機器などの半導体製品にだぶつき感が発生し、各半導体工場における在庫抑制を目的とした生産調整が発生しました。そのためスマートフォンやPC向けパネルそしてパネルを駆動するLCDドライバーチップ等の在庫増が嫌気され、デザインハウス及び大手OSATを中心に工場の稼働率は回復の兆しはあるものの、現時点では7割から8割程度であり、市場は新規設備投資に慎重な姿勢を崩しておりません。しかし、2024年を含む中期的には、自動車の電動化、再生エネルギー関連及び5Gへの投資需要が強く見込まれており、また、急速に需要が高まっている生成人工知能(AI)も半導体チップの需要を押し上げる要因となっていることから、市場は力強く成長すると見られております(Electronic Engineering Timesより、以下「EETIMES」という。)

また、近年の半導体の複雑化や集積度向上(例、線幅4nmから2nm)は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性も要求されるため、半導体検査市場は、装置能力の向上に加えて装置台数の増加が期待される方向と考えられております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、スマートフォンやPC等の情報端末の液晶パネルの駆動に使われる「ディスプレイドライバーIC」の検査に使用されております。また、それら情報端末には、「CMOSイメージセンサーIC」、「ロジックIC」など多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。現状足元では、上記のように半導体市場の足踏み状態が続いておりますが、中長期的には需要も戻り、大きな伸びが期待される分野です。

上述のような理由から当第2四半期連結累計期間中では、受注は低迷致しましたが、当社の主力検査装置「WTS-577SR」につきましては、2021年から販売を開始し、当第2四半期連結累計期間において、進化する新デバイスに向けた装置の貸出しを伴うベンチマークを積極的に進め、お客様から量産ラインへの投入評価をいただくことができました。

2023年の半導体市場は、世界半導体市場統計(WSTS)や日本貿易振興機構(JETRO)等の予想では、民生向け半導体(スマートフォン、PC向け半導体等)を中心として、依然として生産調整が2023年後半まで続くとの見方があります。他方、半導体製造装置セクターにおいては、2023年前半は落ち込むが後半から2024年にかけて徐々に回復との予測もあり、当社においては、半導体検査装置の受注は2023年2月14日に公表している通期予想に組込んでおります。

新戦略として、2023年3月6日に開示いたしましたとおり、新たに日本における大手再生シリコンウエーハ製造会社である株式会社RSテクノロジーズ(東京都品川区、代表取締役 方 永義)を販売店に迎え、国内外の受注拡大を狙います。

また、当社の中国製造子会社「偉恩測試技術(武漢)有限公司」(以下、「ウインテスト武漢」という。)の営業体制の拡大強化を行い、特に中国、台湾においての直接受注を目指します。また、海外営業と海外アフターサポート体制の拡充を進め、営業活動の再構築を図ってまいります。

次に、ウインテスト武漢においては、顧客対応力の強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。

さらに中国市場攻略のスピードアップを進めるため、ウインテスト武漢において、大手優良デザインハウス数社に的を絞った戦略を取り、関連するOSATへの貸出しを進め、営業・納入・サポートと一貫体制を敷き、顧客からの信頼獲

得を図ってまいります。

2. 技術開発の強化

先端ロジックIC検査装置 (1024チャンネル、820Mbps) に関しては、第1四半期に前倒しで一部機能のリリースを行い、引続き次世代向け機能としてロジックパターンスピードが1,600Mbpsとなる高速リソースの開発を継続しており、当第4四半期中には開発を終了し、お客様への提供を開始する予定です。更に「WTS-9000S」次世代のフラッグシップ検査装置に先立ち「WTS-577SX」のリリースを同じく当第4四半期を目途に計画をしております。

「WTS-577SX」に関して、国内、台湾、中国顧客向けを想定した開発を継続しており、多くの部分を現在開発中の次世代LCDドライバー検査装置へ共用の上、使い勝手の向上に向けて新GUIを装備し、コスト削減と市場への早期リリースができるように計画をしております。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用し、且つ当社、ウインテスト武漢の技術陣に加え、現地有力企業より営業方面・技術方面での協力体制を構築することで、2025年までに、今後市場拡大が見込まれるシステムオンチップ (SoC) 市場や汎用デジタル市場等の検査分野、そしてM&Aも計画し、日本市場においても注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、資本提携や協力体制を積極的に進め、新規市場参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を行い、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

3. 隣接領域の展開と製品化

検査装置向け工場FA化機器技術 (「自重補償機構技術」) については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については、既にお知らせのとおり手続きは終了しております。当該技術は当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター (以下「ボゴタワー」という。) の着脱 (約25kg~30kg) をオペレーター一人で簡単に安全に行うための補助アーム (以下「マニピュレータ」という。) で製品化を目指し、当面の目標として、その搬送可能重量を50kg前後で製品化を行います。現在は、製品の製造準備に取り掛かっており、先端ロボット等の開発製造をロボット等製造事業者様と協議を開始いたしました。また当該技術は、「半導体製造工場内FA化システム」、「物流搬送システム」並びに「介護等」への応用が可能と考えております。

奈良県立大学と進めております脈波 (BCG, ECG) を利用したヘルスケア管理システムは、同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを組み、製品化を行いました。2023年3月9日に開示しました「IoTセンサーを活用したセルフヘルスケア機器の販売開始決定及び価格に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、2023年4月1日より一部のお客様を中心に試験販売を開始いたしました。なお、当該製品の製造に関しましては当社大阪事業所で製造を行うように準備を進めており、2023年9月から順次市場投入を計画しております。また、製品の納品後もアップデートによる機能の追加、検査項目の拡充を積極的に進め、地域医療に貢献できるようにしてまいります。なお、機器の詳細につきましては、当社WEBページをご参照ください。

財務施策

財務面については、事業拡張を考えた財務戦略として、筆頭株主である武漢精測と諮りながら、武漢精測グループ及び投資機関からの資本増強あるいは同グループからの借入を計画し、資金確保についての施策を今後とも継続実施してまいります。

以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定でありますが、アフターコロナ、テレワーク需要の減少などの影響で半導体市場は、在庫の積み上がりや嫌気、生産調整から設備投資の大幅な減退を受けて大きく低迷しております。当社がメイン市場とする海外の新規受注並びに受注済み検査装置の出荷、売上は、中国経済が上向くと見込まれる当年度半ば以降となります。事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、需要動向等の今後の外部環境の影響を受けること、資金の調達についても確約されるものではないことから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、当四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四半期連結財務諸表に反映しておりません

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)

当社は、当第2四半期連結累計期間に、第三者割当の方法による第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ216,669千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が1,427,232千円、資本剰余金が1,713,719千円となっております。

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用方針)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)

「II 当第2四半期連結累計期間 (報告セグメントの変更等に関する事項)」に記載のとおりです。

II 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)

当社グループは、「半導体検査装置事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループは、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、第1四半期連結会計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、前連結会計年度に「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を株式会社データゲート (大阪府大阪市北区) に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったため、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

当社の報告セグメントは単一セグメントになることから、前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間におけるセグメントの情報の記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは前連結会計年度において、半導体需要のダブつきによる工場稼働率の調整の影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高210,315千円と低調な結果となり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上しております。

当第2四半期連結累計期間においては、2022年8月から顕在化した民生向け半導体の在庫調整も2023年上半期には一段落するものと予測されておりましたが、在庫調整の回復にはまだ時間がかかる見込みです。そのため、2023年6月末時点において、スマートフォンやPCなどの需要低迷の影響から、主にそれら機器で使用される半導体を中心にだぶつき感が否めない状況が続いており、顧客の各工場が、生産調整に入っていることから当第2四半期連結累計期間中の受注は低調に推移しました。顧客の新規設備投資は当社第3四半期以降に開始される見込みです。

以上より、当社グループの連結ベース売上高は、186,416千円にとどまり、営業損失249,453千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を240,594千円計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、306,840千円のマイナスとなりました。

上記のとおり、継続的な営業損失及び営業キャッシュフローのマイナスが発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループでは、こうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、継続企業の前提に関する事項及びその対応策に関しましては、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(継続企業の前提に関する注記)」に記載しております。